2022년 1월 17일(월) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
* 통신 · 방송 · 인터넷은 1월 16일(일) 12:00 이후 보도 가능

중소벤처기업부 **보 도 자 료** 대한민국 대전환 한국판뉴딜

• 문의 : 중소벤처기업부 기술개발과 윤석배 과장(044-204-7760),
권희준 사무관(7762), 최혜진 주무관(7767)

'22년 소재 · 부품 · 장비 전략협력 기술개발사업 참여 중소기업 모집

□ 소재·부품·장비 분야 유망 중소기업의 혁신 기술개발을 촉진하기 위해 운영기관*과 협력기술개발(R&D)을 수행할 중소기업 모집
* (운영기관) 한국과학기술원, 한국전자기술연구원

□ 1단계(R&D 공동기획)에는 최대 1.5개월간 1천 5백만원을 지원하고, 2단계(R&D 공동수행)에는 최대 2년간 8억원 지원

□ 참여 희망 중소기업은 범부처통합연구지원시스템(www.iris.go.kr)에서 신청
* (공고) '22.1.17(월) ~ 2.7(월) / (접수) '22.1.31(월) ~ 2.7(월)

중소벤처기업부(장관 권칠승, 이하 중기부)는 '22년 '소재·부품·장비 전략협력기술개발사업' 과제에 참여할 중소기업을 1월 17일(월)부터 2월 7일(월)까지 모집한다고 밝혔다.

'소재·부품·장비 전략협력기술개발사업'은 소재·부품·장비 분야의 기술·기반(인프라)·인력을 보유한 대학·연구기관(운영기관)과 함께

소재·부품·장비 관련 중소기업의 혁신 기술개발을 촉진하기 위한 사업으로 소재·부품·장비 분야 연구역량을 보유한 중소기업이 참여할 수 있다.

< 소재·부품·장비 전략협력 R&D 개요 >

◈ (목적) 유망 중소·벤처기업이 소부장 분야의 기술·인프라·인력을 보유한 운영기관(한국과학기술원, 한국전자기술연구원)과 함께 소부장 분야의 혁신 기술개발을 촉진

◈ (주요내용) 운영기관 · 소부장기업 협력 기술개발(R&D) 과제에 최대 1.5개월, 1천 5백만원(1단계), 최대 2년, 8억원(2단계) 지원

단계	수행기관	지원내용
(1단계) R&D 공동기획	운영기관-참여기업	과제당 최대 1.5개월, 15백만원(10개)
(2단계) R&D 공동수행	운영기관-참여기업	과제당 최대 2년, 8억원(7개)

이번 공고를 통해 1단계 '기술개발(R&D) 공동기획'에 참여할 중소기업 10개 사를 선정할 예정이며,

선정된 기업은 최대 1.5개월간 1천 5백만원을 지원받아 운영기관과 공동으로 2단계(R&D 공동수행)에 지원하기 위한 기술개발을 기획하게 된다.

1단계(R&D 공동기획) 과제수행이 완료되면, 심사를 거쳐 기술성 등이 우수한 과제 7개를 2단계(R&D 공동수행) 과제로 최종 선정해 최대 2년간 8억원의 기술개발 자금을 지원한다.

중기부 원영준 기술혁신정책관은 "소재·부품·장비 전략협력기술개발 사업을 통해 국내 소재·부품·장비 관련 중소기업의 대외 기술경쟁력을 강화하고, 신속한 기술자립이 실현될 수 있도록 지속적으로 지원할 것"이라고 밝혔다.

사업 신청은 '22년 1월 31일(월)부터 2월 7일(월)까지 가능하며, 자세한 내용은 범부처통합연구지원시스템(www.iris.go.kr)을 통해 확인할 수 있다.

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 중소벤처기업부 기술개발과 권희준 사무관(☎ 044-204-7762)에게 연락주시기 바랍니다.

참고 1 '22년 소재 · 부품 · 장비 전략협력기술개발사업 개요

□ **사업목적** : 소재·부품·장비 분야의 기술·인프라·인력을 보유한 대학·연구기관을 운영기관으로 선정(플랫폼화)하여 소부장 관련 중소기업의 혁신 기술개발 촉진

□ **지원규모** : (1단계) 최대 1.5개월, 15백만원, (2단계) 최대 2년, 8억원

(단위 : 개, 백만원)

구분	지원과제	지원기간 및 한도	정부출연금 비율	지원방식
(1단계) 공동과제기획	10	최대 1.5개월, 15백만원 이내	80%*	지정공모
(2단계) 전략협력R&D	7	최대 2년, 8억원		

* 「코로나-19 대응을 위한 중소기업기술개발 지원사업 특별지침」에 따라 정부출연금 지원비율을 75%에서 80%로 상향 조정

□ **지원대상** : 소재·부품·장비 분야 핵심 전략품목 요소기술과 관련한 연구개발 수행 역량을 보유한 중소기업

□ **지원내용** : 운영기관*에서 발굴·기획된 요소기술을 대상으로 공동 연구개발을 수행할 중소기업 매칭, 과제기획 및 기술개발 등 단계별 지원

* 한국과학기술원(KAIST), 한국전자기술연구원(KETI)

▶ **(1단계 : 공동과제기획)** 운영기관과 참여기업이 2개월간 공동으로 기술개발 기획(1.5개월, 1,500만원 이내)

▶ **(2단계 : 전략협력R&D)** 1단계 공동기획한 과제 중 우수한 과제 최종 선정 → 전략협력 R&D 수행(2년, 8억원 이내)

참고 2 소재 · 부품 · 장비 지원 분야 및 품목

□ 소재 · 부품 · 장비 분야(9대 분야, 104개 품목)

분야	품목명	
기계금속 (17개)	지능형 플라스틱 사출 성형기	실린더
	감속기	압연부품
	금속 3D 적층/절삭 장치	정밀생산기계부품
	냉동오일	제강설비부품
	동력전달장치용 부품	제강소재
	로봇용 서보모터	초경량 및 고기능성을 가지는 금속 기반 이종접합복합 소재
	발전용 연소 장치	내열합금기반 부품 제조를 위한 진공 정밀주조 장치
	베어링	FDM 방식 3D 프린팅 금속분말
	산업용 누설 방지 부품	
미래소재 (11개)	고효율 단열재	유기섬유
	친환경 분해성 소재	플루오린 레진
	UV경화 수지	인공근육용 저온 상전이 소재
	고부가 에폭시 수지	체내 주입형 생분해성 형상기억 고분자 소재
	고품질 인쇄용 잉크소재 및 장치	산화물 기반 고체전해질 소재
	점접착제	
디스플레이 (11개)	평판디스플레이 제조 로봇	디스플레이용 양자점 소재
	박막봉지 소재/장치	디스플레이용 증착 및 식각 장치 및 부품
	OLED 발광소재	이방성 전도 필름
	고유연·고경도 디스플레이용 소재	마이크로 LED 칩 전사장치
	디스플레이용 광·전자기 세라믹	고투명, 고경도 무기 하이브리드 코팅 소재
	디스플레이용 배리어 필름	
반도체 (13개)	반도체 리페어 장치	실리콘 웨이퍼
	고성능 반도체 패턴용 공정 소재	반도체 세정 장치 및 부품
	반도체 노광 공정/장치	반도체 측정/분석/검사 장치 및 부품
	반도체 CMP 장치 및 부품	전력(파워)반도체(Power IC)
	반도체 식각공정 부품	루테늄(Ru) 박막의 ALD 전구체
	반도체 증착 장치 및 부품	고효율 유무기 하이브리드 방열 소재
	반도체용 특수가스	
자동차 (11개)	차량용 지능형반도체	조향 부품
	엔진 주변 부품	차량용 동력전달장치
	자동차용 복합소재	4D FMCW 라이다 신호처리 소프트웨어
	전장 및 제어·열관리 시스템	EVITA secure 기반 보안 반도체 및 암호화 모듈
	수소 저장·운반용 복합 소재	대형 자동차용 스퍼터링 및 아크 하이브리드 장치 및 전원 장치
	운전자 편의 시스템	

분야	품목명	
전기전자 (10개)	통신용 전력증폭 소자	MLCC
	광학부품 및 기기	수동소자
	이차전지 분리막	RF부품
	이차전지 전극/전해액 첨가 소재	황화리튬 소재
	이차전지용 파우치	초고전압용 세라믹 적층콘덴서(MLCC) 내부전극
바이오 (12개)	바이오의약품 생산 정제 공정 시스템 및 부품	바이오의약품 생산용 배지
	바이오의약품 생산 품질 분석 시스템	방사선 진단 장치
	바이오의약품 생산 품질 관리 시스템	의료용 레이저 장치
	바이오의약품 생산 배양시스템	초병렬적 합성 핵산 후처리 장치
	바이오의약품 생산 제품분석용 소모품	대체육 유형별 소재
	바이오의약품 생산 배양 공정 관리 시스템 및 부품	곤충기반 친환경 사료
그린에너지 (14개)	고출력·고효율 태양전지 셀	TMS 부품
	수소충전소 핵심부품	TOC 측정기 및 부품
	건물용 연료전지 MEA(Membrane Electrode Assembly)	질소산화물 센서
	수전해용 차세대 핵심소재	공업용 순수 생산 핵심소재/장치
	태양전지용 CVD 장치	VOCs 저감 장치
	연료전지용 열교환기	세라믹 전해전지 스택
	태양전지용 소재	고효율 헤파필터
비대면 디지털 (5개)	대용량·초고속 광송신 및 수신부품(LD,PD)	RF Beamforming용 저전력 PIM 반도체
	Bio Processor용 저전력 PIM 반도체	고해상도 MIMO 레이더 칩셋 및 패키지
	Sub-THz급 Multi-Channel 레이더 칩셋	